

高熱伝導化が進む放熱材料とその評価

～電子機器の効率的な冷却のために～

主催：名古屋市工業研究所

協賛：中部エレクトロニクス振興会

ますます発熱密度が高くなる電子機器の放熱には高熱伝導材料が欠かせません。本講演会では最新の放熱シートに関する技術情報、現在広く使われている様々な冷却マテリアルの特徴を紹介します。また、これらの熱特性を評価する技術について解説します。多数のご聴講をお待ちしております。

日時：2026年6月3日(水) 13:30～16:30

(受付13:00～)

参加費無料!

定員 50名

場所：名古屋市工業研究所 第2研修室(管理棟3階)

13:30～13:35 開会あいさつ

13:35～14:00 「高熱伝導材料の測定技術と過渡熱測定の紹介」

講師：名古屋市工業研究所 システム技術部生産システム研究室 梶田 欣

14:00～14:40 「初心者でも簡単！過渡熱抵抗測定を使った熱伝導率測定」

講師：サーデアウ株式会社 技術営業部信頼性故障解析アドバイザー 近藤 茂 氏

14:40～15:00 休憩(名刺交換)

15:00～15:40 「幅広く使用される Thermal Interface Material」

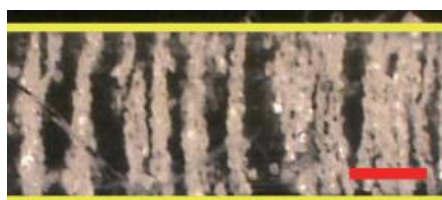
車載デバイス、データセンターの高発熱化に伴い、TIM(Thermal Interface Material)の需要は増加傾向にある。加えてTIMの種類も様々で用途に応じて適切なTIMを選択する必要がある。本講演ではTIMの種類や特徴、CX-TIMを用いた弊社TIMの熱物性測定事例についての発表を行う。

講師：富士高分子工業株式会社 開発部 今枝 悠太 氏

15:40～16:30 「電界整列技術による放熱シートの熱伝導性向上」

近年、パワーデバイスの小型化・高集積化に伴い高効率の放熱が重要となっており、合成樹脂(母材)と高熱伝導性フィラーを組み合わせた複合材料である放熱シートが注目されている。我々は、ダイヤモンド微粒子などの熱伝導性粒子をフィラーとして、電界整列を用いてフィラーを整列させた放熱シートを作製し、その熱伝導特性の向上を目指している。その際、フィラーと母材の比重の違いから、フィラーが沈降し、電界整列による熱伝導性向上が十分に発揮できない課題があった。本発表では、サンプルを回転させる機構により重力の影響を抑制した回転電極電界整列による熱伝導率向上効果について報告する。

講師：関西大学 システム理工学部 グリーンエレクトロニクス工学科准教授 稲葉 優文 氏



会場:名古屋市工業研究所

第2研修室(管理棟3階)

最寄駅…地下鉄名港線「六番町」(3番出口)

<https://www.nmiri.city.nagoya.jp/access.html>

参加費 : 無料

定員 : 50名(先着順)



申込方法: FAX… 下記申込書にご記入の上お送りください。

E-mail… メール本文にて必要事項(ご所属、部署・役職、お名前、連絡先)を記載してお送り下さい。

申込・問合先:名古屋市工業研究所 システム技術部 生産システム研究室 梶田欣

FAX: 052-654-9952 TEL: 052-654-9940 (ダイヤルイン)

E-mail: kajita.yasushi@nmiri.city.nagoya.jp

※送信後1週間たっても返信がない場合は、お手数ですがお電話にてご連絡ください。

高熱伝導化が進む放熱材料とその評価 ～電子機器の効率的な冷却のために～

講演会申込書

FAX: 052-654-9952 梶田行

ご所属(社名等)	
部署・役職/ お名前	※複数名でのお申し込み可※
E-mail	
TEL	
備考・質問	(講師へのご質問等があればお書きください)
メルマガジン(NMIRI 技術ニュース)申し込み	希望する ・ 希望しない ・ 申込済

※ご記入頂いた個人情報は、受講者への連絡・講師への情報提供など講演会目的、(希望者への)メルマガ配信以外には使用いたしません。